

中国国际金融股份有限公司

关于聚辰半导体股份有限公司

2021 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为聚辰半导体股份有限公司（以下简称“聚辰股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责聚辰股份上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 |
|----|--|--|
| 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划 |
| 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 保荐机构与聚辰股份签订的《保荐协议》中明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案 |
| 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解聚辰股份业务情况，对聚辰股份开展了持续督导工作 |
| 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告 | 聚辰股份在本持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况 |
| 5 | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施 | 聚辰股份在本持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项 |
| 6 | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺 | 在本持续督导期间，保荐机构督导聚辰股份及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺 |
| 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 保荐机构督促聚辰股份依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度 |

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 |
|----|---|---|
| 8 | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等 | 保荐机构对聚辰股份的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，聚辰股份的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营 |
| 9 | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 保荐机构督促聚辰股份严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件 |
| 10 | 对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告 | 保荐机构对聚辰股份的信息披露文件进行了审阅，不存在根据相关规定应及时向上海证券交易所报告的情况 |
| 11 | 关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正 | 本持续督导期间，聚辰股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项 |
| 12 | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告 | 持本续督导期间，聚辰股份及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况 |
| 13 | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告 | 经保荐机构核查，本持续督导期间，聚辰股份未发生该等情况 |
| 14 | 发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形 | 本持续督导期间，聚辰股份未发生该等情况 |
| 15 | 上市公司出现以下情形之一的，保荐人应当自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场核查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50% 以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形 | 本持续督导期间，聚辰股份未发生该等情况 |

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司面临的主要重大风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、市场竞争加剧导致市场价格下降、行业利润缩减的风险

集成电路设计行业公司众多，市场竞争逐步加剧。国际方面，与意法半导体、微芯科技等国际大型厂商相比，公司在整体规模、资金实力、海外渠道等方面仍然存在一定的差距。国内方面，随着本土竞争对手日渐加入市场，竞争对手的低价竞争策略可能导致市场价格下降、行业利润缩减等状况。未来随着市场竞争的进一步加剧，公司若不能建立有效的应对措施，将可能面临主要产品价格下降、利润空间缩减的风险。

2、技术升级迭代风险

集成电路设计行业技术升级和产品更新换代速度较快，并且发展方向具有一定不确定性，因此集成电路设计企业需要正确判断行业发展方向，根据市场需求变动和工艺水平发展及时对现有技术进行升级换代，以持续保持产品竞争力。未来若公司的技术升级迭代进度和成果未达预期，致使技术水平落后于行业升级换代水平，将影响公司产品竞争力并错失市场发展机会，对公司未来业务发展造成不利影响。

3、研发失败风险

集成电路设计公司需要持续进行现有产品的升级更新和新产品的开发，以适应不断变化的市场需求。公司需要结合技术发展和市场需求，确定新产品的研发方向，并在研发过程中持续进行大量的资金和人员投入。由于技术的产业化和市场化始终具有一定的不确定性，未来如果公司在研发方向上未能正确做出判断，在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临研发失败的风险，前期的研发投入将难以收回，对公司业绩产生不利影响。

4、人才流失风险

集成电路设计行业为人才密集型行业，具有扎实专业功底和丰富行业经验的人力资

源是企业的核心竞争力之一。随着行业竞争日益激烈，企业间对人才的争夺加剧，公司技术人才存在流失风险。公司目前多项产品和技术处于研发阶段，技术人才的稳定对公司的发展尤为重要，如果公司未能继续加强对技术人才的激励和保护力度，导致技术人才大量流失，将对公司经营产生不利影响。

（二）经营风险

1、原材料供应及委外加工风险

公司为通过 Fabless 模式开展业务的集成电路设计企业，专注于芯片的研发与设计，而将晶圆制造、封装测试等生产环节通过委外方式进行。公司向晶圆制造企业采购晶圆，委托封装测试厂进行封装和测试。若晶圆市场价格、委外加工费大幅上涨，或由于晶圆供货短缺，委外供应商产能不足、生产管理水平欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的盈利能力、产品出货造成不利影响。此外，公司供应商集中度较高，采购相对比较集中。未来若供应商业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，可能导致供应商不能足量及时出货，对公司生产经营产生不利影响。

2、业务推广情况影响公司销售的风险

根据公司的业务模式，公司通常与客户签订销售框架性协议，并约定根据客户正式发送的订单进行销售。该等业务模式下，客户通常视其一定期间内对公司产品的需求及预测进行采购，而公司的业务推广情况、具体项目获取情况等因素均可能引起客户对公司产品需求量的变动。若因公司业务推广不顺利等原因导致客户对公司产品需求量、采购量减少，可能对公司产品的销售情况、公司经营业绩产生不利影响。

3、产品价格下降的风险

由于公司所处集成电路行业所具有的产品更新换代相对较快、既有的集成电路芯片产品的平均单价在同系列新产品推出后将有所下降，以及下游厂商对成本控制的日益加强、行业内竞争日趋激烈带来的价格竞争压力，使公司主要产品平均销售价格近年来总体降低，且不排除未来存在进一步下降的可能性。公司产品价格的下降可能对公司未来的经营业绩及财务状况造成不利影响。

（三）行业风险

2020 年下半年以来，受“新型冠状病毒肺炎”疫情、国际贸易环境变化、芯片下

游应用市场需求增加、集成电路设计企业增加备货等因素影响，全球晶圆代工厂产能普遍进入比较紧张的周期。若晶圆市场价格、外协加工费价格大幅上涨，或由于晶圆供货短缺、供应商产能不足、生产管理水平欠佳等原因影响公司的产品生产，将会对公司的盈利能力、产品出货造成不利影响。

（四）宏观环境风险

1、“新型冠状病毒肺炎”疫情的风险

2020年1月以来，国内外爆发“新型冠状病毒肺炎”疫情，限制并缩减了经济社会活动，下游终端应用市场需求处于短期紧缩状态，对行业和公司的发展均产生了一定的负面影响。如果未来疫情不能得到及时控制或影响范围进一步扩大，宏观经济形势发生剧烈波动，导致下游各终端应用市场对公司产品需求减少，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

2、贸易摩擦的风险

近年来国际贸易环境的不确定性增加，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分国家通过贸易保护的手段，对我国部分产业的发展带来一定的冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作特点，若未来国际贸易环境发生重大不利变化、中美贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能导致公司业务发展受限、供应商无法供货或客户采购受到约束，公司的正常生产经营将受到重大不利影响。

四、重大违规事项

2021年1-6月，公司未发生重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021年1-6月，公司主要财务数据及指标如下：

| 主要财务数据 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度（%） |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入（元） | 264,480,149.39 | 218,142,429.25 | 21.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,752,158.51 | 46,558,182.96 | 41.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,735,809.81 | 39,963,462.36 | -23.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 47,963,944.71 | 29,290,387.31 | 63.75 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 变动幅度（%） |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------|
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,478,047,674.11 | 1,461,079,275.65 | 1.16 |
| 总资产（元） | 1,597,598,809.38 | 1,556,469,946.19 | 2.64 |

| 主要财务指标 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度（%） |
|-------------------------|-------|-------|--------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.39 | 39.52 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.54 | 0.39 | 39.52 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.33 | -22.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.40 | 3.46 | 增加 0.94 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.06 | 2.97 | 减少 0.91 个百分点 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 12.17 | 10.25 | 增加 1.92 个百分点 |

上述主要财务指标的变动原因如下：

1、报告期内公司营业收入较上年同期增长 21.24%，主要系 2020 年上半年因新冠疫情的影响使公司下游终端应用市场需求短期紧缩，而本期相关需求回暖、公司销售情况恢复所致；

2、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 41.23%，主要系公司于 2020 年 7 月通过聚源芯星间接参与中芯国际战略配售，本期按出资份额确认公允价值变动收益，相关收益计入非经常损益所致；

3、报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 23.09%，主要系公司综合毛利率因主要产品降价影响而有所降低、公司加强对现有产品的完善升级及对新产品的研究开发使研发投入增长、公司本期闲置募集资金用于投资保本型理财产品且相关收益计入非经常性损益及受人民币升值影响公司汇兑收益有所减少所致；

4、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 63.75%，主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

5、报告期内公司基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增加 39.52%，主要系公司前述归属于上市公司股东的净利润增长所致；

6、报告期内公司扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 22.93%，主要系公司前述归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致；

7、报告期内公司加权平均净资产收益率较上年同期增加 0.94 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期下降 0.91 个百分点，主要系公司前述归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的变动所致；

8、报告期内公司研发投入占营业收入的比例较上年同期增加 1.92 个百分点，主要系公司加强对现有产品的完善与升级以及对新产品的研究与开发，研发人员薪酬及研发项目开支增长所致。

综上，公司 2021 年 1-6 月主要财务数据及财务指标的变动具有合理性。

六、核心竞争力的变化情况

公司是一家集成电路设计高新技术企业，专门从事高性能、高品质集成电路产品的研发设计和销售，并提供应用解决方案和技术支持服务。公司目前拥有非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线，产品广泛应用于智能手机、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子、工业控制等众多领域。

公司凭借领先的研发能力、可靠的产品质量和优秀的客户服务水平，在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源。根据赛迪顾问等第三方机构统计，从 2018 年起，公司成为全球排名第三的 EEPROM 产品供应商，市场份额在国内 EEPROM 企业中排名第一。公司已成为智能手机摄像头 EEPROM 芯片的领先品牌，并与行业领先的智能手机摄像头模组厂商形成了长期稳定的合作关系，产品应用于大部分市场主流手机厂商的消费终端产品。丰富的现有客户资源也为公司新产品的市场开拓提供了便利，可以实现多类产品的销售协同，产品的推出、升级和更新换代更易被市场接受，为公司的业务拓展和收入的增长打下了良好的基础。

2021 年 1-6 月，公司继续深耕各主要产品线，在该等领域持续开展技术研发与产品升级，持续保持公司竞争优势。

综上所述，2021 年 1-6 月，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

1、研发支出及变化情况

公司以技术研发为核心，为维持产品及技术优势，持续投入较多研发支出。2021年1-6月，公司研发费用为3,218.09万元，较上年同期增长43.87%；研发费用占营业收入的比重达到12.17%，较上年同期研发费用率增加1.92个百分点，主要系公司加强对现有产品的完善与升级以及对新产品的研究与开发，研发人员薪酬及研发项目开支增长所致。

2、研发进展

报告期内，公司中置音圈马达驱动芯片产品荣获《电子工程专辑》、《电子技术设计》和《国际电子商情》联合颁发的“2021年中国IC设计成就奖——年度最佳驱动芯片/LED驱动IC”。

公司2021年上半年申请境内发明专利1项，取得境内发明专利授权4项、实用新型专利授权1项；申请集成电路布图设计登记证书3项，获得集成电路布图设计登记证书16项。截至2021年6月末，公司累计获得发明专利46项（其中境内41项、美国5项）、实用新型专利17项、集成电路布图设计登记证书67项、计算机软件著作权3项，目前正在申请的境内发明专利19项，建立起了完整的自主知识产权体系。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至2021年6月30日，公司累计使用的募集资金为153,303,657.05元，募集资金专户余额为200,387,890.98元，使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为593,000,000.00元。

截至2021年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------------|----------------|
| 2020年12月31日募集资金专户余额 | 111,238,624.53 |
| 减：2021年半年度募投项目支出金额 | 67,707,528.76 |
| 累计使用闲置募集资金现金管理金额 | 710,000,000.00 |

| 项目 | 金额（元） |
|----------------------|----------------|
| 加：累计使用闲置募集资金现金管理赎回金额 | 855,000,000.00 |
| 闲置募集资金现金管理收益金额 | 11,031,577.15 |
| 累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额 | 825,218.06 |
| 2021年6月30日募集资金专户余额 | 200,387,890.98 |

截至2021年6月30日，公司募集资金存储余额情况如下：

| 开户银行名称 | 银行账号 | 存储方式 | 金额（元） |
|------------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 中国建设银行股份有限公司上海张江分行 | 31050161393600004180 | 活期存款 | 120,557,926.28 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行 | 1001281229007038620 | 活期存款 | 67,058,557.92 |
| 上海银行股份有限公司松江支行 | 03004028162 | 活期存款 | 8,259,302.90 |
| 盛京银行股份有限公司北京五棵松支行 | 0110400102000008190 | 活期存款 | 4,512,103.88 |
| 合计 | | | 200,387,890.98 |

公司已使用部分暂时闲置募集资金（不超过人民币82,000.00万元）进行现金管理，具体情况详见公司于2021年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司2021年1-6月募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2021年6月末，公司控股股东江西和光投资管理有限公司持有公司25,703,785股股份，持股比例为21.27%，相关股份不存在质押、冻结情形。自公司上市以来，公

司控股股东持有的公司股份不存在减持情形。

自公司上市以来至 2021 年 6 月末，公司实际控制人及时任董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司股份。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

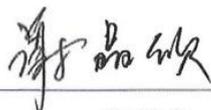
2021 年 1 月 1 日起至本报告出具日，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、核心技术人员离职等事项进行了核查，并对公司 2020 年年度报告问询函相关问题进行了专项核查，相关意见具体请见公司于披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

除上述事项外，公司 2021 年 1-6 月不存在其他应当由保荐机构发表意见的重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



谢晶欣



幸科



中国国际金融股份有限公司

2021 年 9 月 3 日